

東京ハイパワー

HL-810Jによるテクノウ

株式会社東京ハイパワー 技術部 富崎 喜一

設計方針

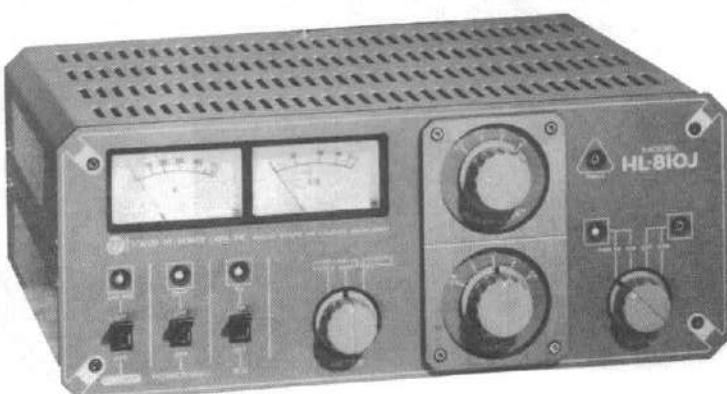
リニア・アンプに使用するパワー・デバイスについて、トランジスタは第1表に示すように真空管よりも利点が多く、アマチュアにとって使いやすいことは、今まで一般的によく知られているとおりです。

しかし、HF帯における100W以上のトランジスタ式リニア・アンプが、企業ベースで製品化されるケースが少ない理由の一つは、第1表の5にあるように、アンテナとの不整合、過剰ドライブ、定格を超えた電源電圧の供給などの電気的なストレスに対し、破壊しやすい欠点を持っていることです。そのため保護装置が必要となり、回路が複雑になると、電圧の選び方によっては、電圧を安定化しなければならず、この部分でコスト高になること、また、トランジスタの性能ギリギリで動作させるような使い方をせず、余裕度をもたせた設計を行う必要があり、できあがった製品は結局、真空管式とあまり変わらない価格になってしまふことが考えられるわけです。

当社、技術部ではこれらの問題をふまえて、信頼度と経済性を考慮し、次の点を設計の基本方針として、開

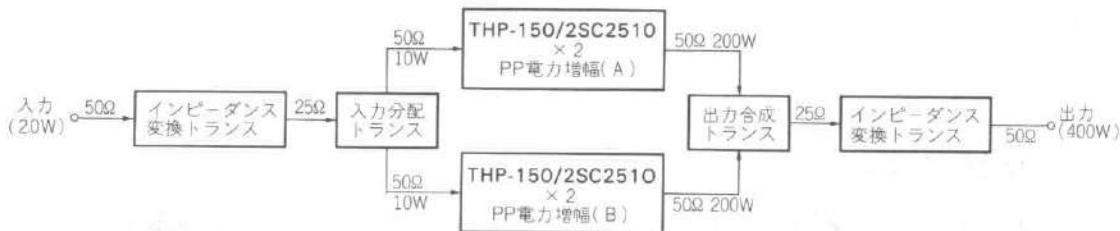
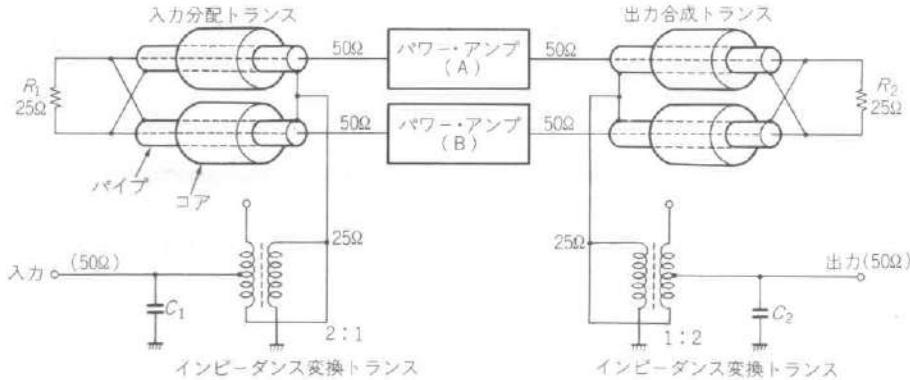
第1表 出力500W程度の真空管式とトランジスタ式の特徴

		真空管	トランジスタ	
1	増幅素子の価格について	一般的に高価で、年々上昇する傾向	欠点	品種を選んで合成回路を用いれば、真空管ほど高くならない
2	性能の経年変化について	寿命があり、定期的に新しいものとの交換を要する	欠点	正常な状態で使用する限り、真空管より寿命が長い
3	スイッチON後のウォームアップについて	ヒーターが所定の温度に達するまでの時間を要する	欠点	スイッチを入れれば、すぐ動作可能
4	終段の調整について	バンドを切り替えるつど、チューニングが必要	欠点	容易に広帯域設計が可能で、バンドごとのチューニングが不要
5	電気的な強度について	ストレスに強い	利点	ストレスに弱く、アンテナの不整合やオーバードライブで破壊しやすい保護回路が必要（回路が複雑になる）
6	電源回路について	数百ボルト～数キロボルトを必要とし、メンテナンスなどの際、危険が伴う	欠点	12V～100Vくらいでよく、比較的の危険性は低い



HL-810Jの外観▶

第1図 終段構成

第2図
パワー・アンプの並列接続合成回路

発に着手しました。

- ① 当社の真空管式リニア・アンプ H L-2400のパネル・デザインを踏襲し、製品のシリーズ化を図る。
- ② 定格出力を400Wとする。
- ③ 10Wでフルドライブできる設計とする。
- ④ 電源電圧は、アフターケアの際のパワー・デバイスの入手性と、コストからみて、DC 27Vとする。
- ⑤ 各社 HF トランシーバーのパネル・サイズに合わせ、コンパクトな外形とする。
- ⑥ 直流電源部 (HP-810) はセパレート・タイプとし、本体のパネル・デザインと寸法を統一する。
- ⑦ 信頼性の強化のため保護回路を多用し、部分的にオートマチック方式を採用して、なるべく使いにくさを

避ける。

特 徴

(1) 並列合成回路による終段電力増幅

広帯域パッシュブル・アンプ 2台の入・出力を合成した、並列運転方式です。構成を第1図に、実際の入力分配、出力合成の様子を第2図に示します。

取り扱う高周波電力が低い場合は、2個以上のトランジスタのベース間およびコレクタ間を、それぞれ単純にパラレル接続するか、ベース側だけでも簡単なCR分配回路を挿入する方法で、比較的容易に設計することができますが、ある程度高いレベルの電力となると、低インピーダンス大電流となり、入・出力側とも、位相をよく

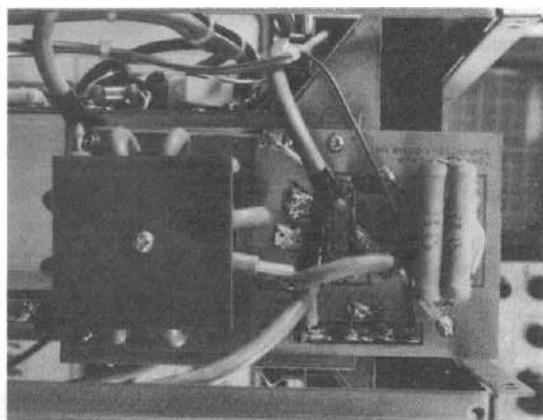
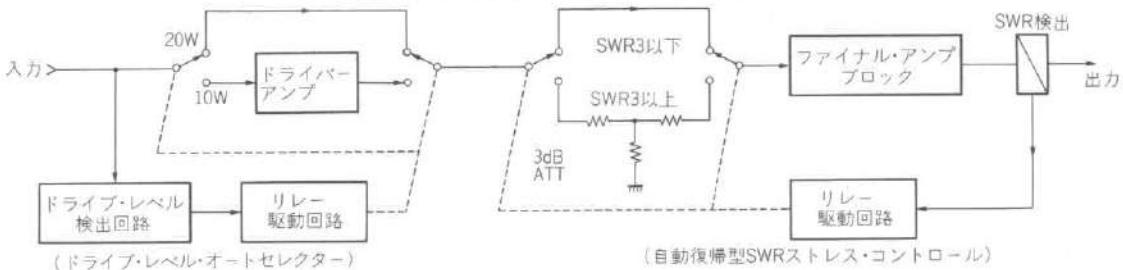


写真1 入力側分配回路の様子



写真2 出力側合成回路の様子

第3図 セーフティ・コントロール・システム



合わせて分配、合成を行わないうまく動作しません。

本機の入力分配回路、および出力合成回路の部品の取り付けの状態を、写真1、写真2に示します。

(2) セーフティ・コントロールによる保護

不適当な使用によるストレスで、終段パワー・トランジスタの破壊や劣化を防止するため、本機では数々の保護装置を設けています。

従来、トランジスタ式リニア・アンプの保護回路では、ストレスが発生すると、自動的にスルー回路に切り替わるなど、リニア・アンプ部の増幅機能が一時停止し、その状態でロックされる場合が通例です。そのため、動作状態へ復帰させるには、リセット・スイッチを操作するか、電源スイッチをいったん切らなければならぬので、使いづらい点があります。

トランシーバーの場合、送信部の終段を保護するには、検出されたストレス信号を前段にフィードバックし、ストレスの大きさにより、自動的かつ無段階的にALC等で送信出力を下げる方法をとれば、目的を達することができます。しかし、リニア・アンプ単体ではドライバー・アンプを1段設けたとしても、同様の働きをさせるには設計的にむずかしさがあります。

本機ではストレスの度合いにより、比較的軽い場合は動作が完全に停止するのではなく、トランジスタが破壊しない程度の出力に下げて機能を維持させ、ストレスが回復すると自動的にもとの出力（定格出力）に戻し、ストレスがさらに高くなると機能を停止させる、というように送信出力を段階的に変化させる方法をとりました。

各種の保護回路について以下に紹介します。

① ドライブ・レベル・オートセレクター

トランシーバーの送信出力が10W機であれば問題ありませんが、100W機でドライバ電力を下げて（SSBではマイク・ゲインを絞って）使う場合、オーバー・ドライブになりやすいことが予想されます。

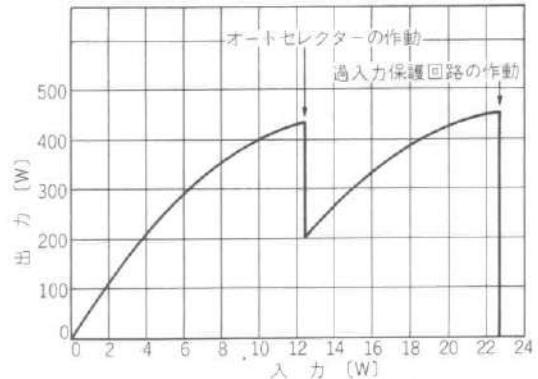
この場合、多少のオーバー・ドライブ——20Wまではドライバー・アンプをスルーザー、終段アンプを直接ドライブするよう自動的に切り替わります（ロックする）。

ブロック図を第3図に示します。

② 自動復帰型SWRストレス・コントロール

第4図 ドライブ・レベル・オートセレクターと

保護回路の動作状況



アンテナ負荷のSWRが3くらいまではフルパワー動作をしますが、SWRが3を超えるとドライブ・レベルを下げ、出力は約50%になります。

SWRが改善され3以下になると、フルパワーに復帰します。

なお、オーバー・ドライブとSWRストレスが同時に加わっても、①と②は同時に作動し、出力はさらに低下してパワー・トランジスタを保護します。

ブロック図を第3図に、回路図を第26図に示します。

③ マルチ・プロテクション

負荷のSWRやオーバー・ドライブなど、パワー・トランジスタにかかるストレスが比較的軽い場合は、(2)のセーフティ・コントロールにより、出力を下げながらも増幅機能を維持させますが、ストレスの程度がさらに高くなつた場合は、自動的に増幅機能を停止させて、その状態にロックし、パワー・トランジスタを保護します。

本機では、次の各種の保護回路を設けました。

保護回路を復帰させるには電源スイッチを切ります。

① 過入力保護

ドライバ電力が10Wを超えると、セーフティ・コントロールにより、自動的に入力20W仕様に切り替わりますが、さらにドライバ電力が増え、20Wを超えると保護回路が作動します。これら一連の動作状況をグラフ化したものを第4図に示します。

② アンテナSWR保護

SWRが約3を超えると、同様にセーフティ・コントロールにより、自動的に出力を下げパワー・トランジスタへのストレスを緩和しますが、SWRがさらに悪化し、SWRが約6を超えると保護回路が作動します。

③バンド切り替えミスセット保護

TV Iの防止用として、 $f_c=40\text{MHz}$ のローパス・フィルターのみ標準装備されています。

各バンドのローパス・フィルターは、オプションにて内部に組み込まれる構造になっていますが、一部または全バンドにローパス・フィルターを組み込んで運用した際、もし間違えて使用周波数より低いバンドにスイッチをセットした場合、フィルターの特性上、リニア・アンプの出力負荷はショートに近い状態になり危険です。

そこで、第27図に示す回路のミスセット・センサーにて保護回路を作動させます。

なお、ミスセット・センサーはオプション扱いで、ローパス・フィルターの取り付けと同時に組み込みます。

④ファイナル・アンプ・アンバランス保護

万一、ブッシュブル・アシブ2組のうち、なんらかの原因で、故障してパワーが出なくなつた場合、出力合成回路の作用がアンバランスになるため、もう片方の正常なアンプの出力負荷がミスマッチとなり、パワー・トランジスタの破壊と合成回路の焼損を招きます。

このような2次故障を防止するため、第28図の回路に示すアンバランス・センサーにて、保護回路を作動させます。

⑤過熱保護

半導体放熱器を本体内部に組み込み、モーター・ファンによる強制空冷を行っています。

万一、運用中なんらかの原因でモーター・ファンの回転が止まつたり、周囲温度の高い場所で使用して、放熱器の表面温度が異常に高くなつた場合、パワー・トランジスタの破壊を防止するため、放熱器表面に取り付けたサーモセンサーにより、保護回路を作動させます。回路を第25図に示します。

⑥電源逆接保護

電源の極性が間違つて接続された場合、ダイオードとパワー・リレーにより確実に保護されます。

(4) 各種アクセサリーの採用

補助機能として、次のようなアクセサリーを採用しています。

- ① HF広帯域受信ブリアンプ
- ② トランシーバー用13.8V電源端子
- ③ 出力レベル切り替え
- ④ 出力電力計
- ⑤ 切り替え式、電源電圧／電流計

定 格

・周波数範囲：3.5MHz, 7MHz, 14MHz, 21MHz,
28MHzの各アマチュア・バンド

・電波型式：A3J, A1, A3

・定格出力：HIレンジにて400W (340~450W) RM
S, 500~600W PEP, 出力4段階切り替え式

・定格終段直流入力：760~1030W DC

・終段電力增幅部型式：AB級広帯域ブッシュブル・ア
ンプ2台並列結合方式

・ドライブ電力(RF入力)：10W/20W (自動/手動切
り替え式)

・入・出力インピーダンス：50Ω (M型コネクター)

・受信ブリアンプ利得：15~20dB

・送信時入力側VSWR：1.2以下 (3.5~28MHz)

〈付属装置〉

セーフティ・コントロール

- ① ドライブ・レベル・オートセレクター
入力10W/20W (入力14W±2Wで作動)
- ② 自動復帰型SWRストレス・コントロール
SWR 3で出力50%にパワー・ダウン、SWR 2
で復帰保護回路
- ③ オーバー・ドライブ・プロテクション
動作レベル、入力23W
- ④ アンテナ・トラブル・プロテクション
動作レベル、SWR 5以上

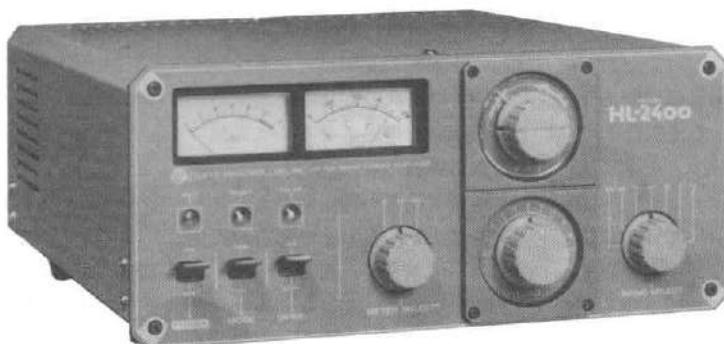
- ⑤ オーバー・ヒート・プロテク
ション

動作レベル、冷却器表面温度
80°C以上

- ⑥ バンド・セレクター・ミスセ
ット・プロテクション (オプ
ション)

動作条件は、使用周波数の下
のバンドにミスセットした場
合

- ⑦ パワーサプライ・ミスセ
ット・プロテクション (電源逆接



真空管式リニア・アンプHL-2400の外観

保護)

- ⑧ パワー・アンプ・アンバランス
 - ・プロテクションファイナル
 - ・アンプの片側が故障した場合のもう一方のアンプの保護。

〈各種コントロール・システム〉

- ⑨ キャリア・コントロール(送・受自動切り替え)
- ⑩ リモート・コントロール(送・受半自動切り替え)

- ⑪ キャリア・コントロール・タイムラグ切り替え(AM/C W/S S B)

- ⑫ パワー切替 H I = フルパワー
M₁ = H I の 60~80%
M₂ = H I の 30~60%
L₀ = H I の 15~30%

入力10Wレベルのみ、4段
切り替え

〈その他のアクセサリー〉

- ⑬ パワー・メーター フルスケール1,000W 確度±15%

- ⑭ 電圧/電流計 フルスケール50V/A 確度±10%

- ⑮ トランシーバー用電源端子 13.8V, MAX 5A (マイナス接地)

- ⑯ RXプリアンプ 高利得広帯域方式

〈使用半導体〉

R F パワー・トランジスタ×8(T H P-150×4, 2 S C 2098×4), パワー・トランジスタ×4(2 S D 526×3, 2 N 3055×1), トランジスタ×13(2 S C 1959×2, 2 S C 1815×5, 2 S A 1015×5, 2 S C 1164, I C × 1(MC 1723 C G), LED×6, ダイオード×35(1 N 60×3, 1 N 4448×19, 1 S 1885×8, 05 Z 2.7×2, 05 Z 6.2 A×2, 3 C C 13×1), サーミスター×2(D-33 A×2)

電源電圧: DC 27V (23~28V) マイナス接地

消費電流: 送信時30~40A, 受信時2~2.5A

付属品: 取扱説明書, リモート・コントロール用プラグ, プラグ付専用電源コード

寸法: 328(W)×131(H)×275(D)mm(突起物は除く)

重量: 9.9kg

オプション

(1) 直流安定化電源

高周波の回り込みに強く、余裕の出力50Aの専用電源 H P-810(受注生産)

〈おもな定格〉

- ・出力: DC 27V/50A
- ・出力電圧: 13.8V・27V切り替え式



写真3 HP-810の外観

・寸法: 328(W)×131(H)×400(D)mm

・重量: 約18kg

H P-810の外観を写真3に示します。

(2) ローパス・フィルター

出力側に取り付ける、各バンドのローパス・フィルターです。本機内部は標準装備の $f_c=40\text{MHz}$ のフィルターも含め、5つのフィルター・ユニットを組み込むスペースを確保しています。

ローパス・フィルターの様子を写真4に示します。

各社HFトランシーバーとの
コンパチビリティ

送・受切り替えはキャリア・コントロールですので、すべてのトランシーバーと組み合わせ使用が可能です。

S S Bでの運用では、リレーのバタツキを少なくするため、スイッチの切り替えによりタイムラグが設定されます。

背面にリモート・コントロール用端子を設けていますので、トランシーバー側に、リニア・アンプ駆動用送・受切り替えリモート端子がついていれば、互いに結線することによって送・受切り替えを連動させることができます(送信時ショートのみ可能)。

リモート・コントロールにより、S S Bでのリレーのバタツキがまったくなく、スムーズに運用できます。

なお、トランシーバーからのA L C信号の利用はできません。

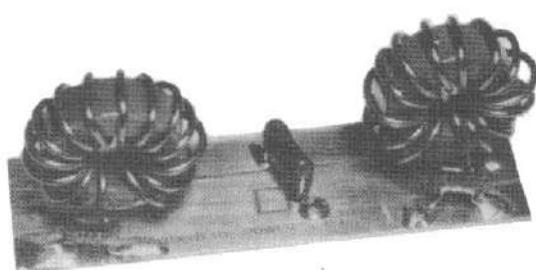
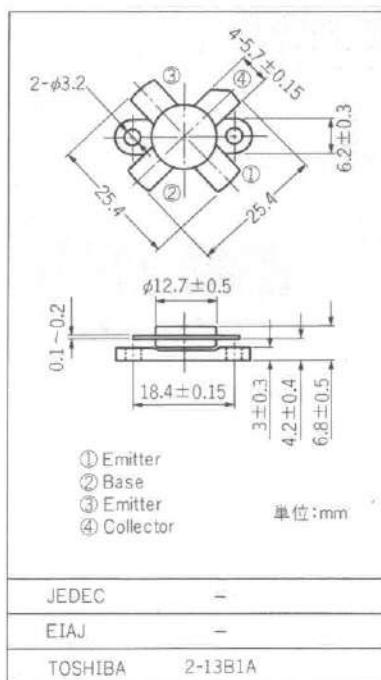
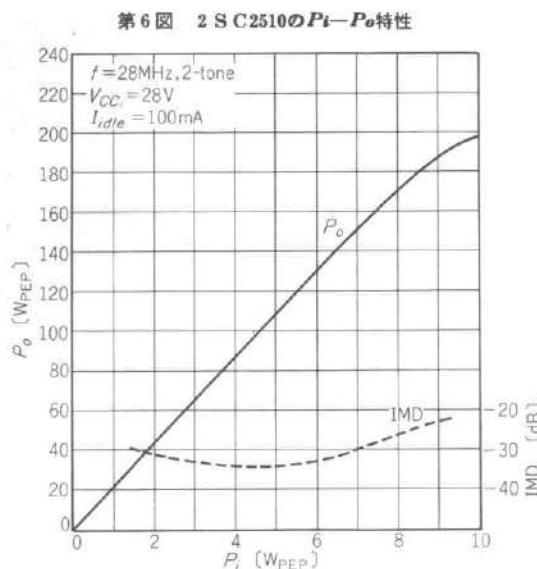


写真4 ローパス・フィルターの外観



第5図
TH P150/2
S C2510の外
形寸法



第6図 2 S C2510のPi-Po特性

使用半導体の規格

終段パワー・トランジスタや、受信ブリアンプに使っているおもな半導体についてご紹介します。

TH P-150/2 S C2510

終段電力増幅用のパワー・トランジスタで、広帯域型ブッシュブル・アンプ2台合成により、4個使用しています。

東芝との特別契約に基づく特別仕様により、トランジスタの製造段階での電気的強度試験、 h_{FE} 測定等にて特性のそろったものを選別し、さらに当社ブランドTH P-150をマーキングしています。

TH P-150/2 S C2510の外形図を第5図に、各特性表を第6図および第2表、第3表に示します。

単体での特性は、第6図に示すように出力の直線性に

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧 (ベース・エミッタ短絡)	V_{CES}	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧 (ベース・エミッタ開放)	V_{CEO}	35	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	4	V
コレクタ電流($T_C=25^\circ\text{C}$)	I_C	20	A
コレクタ損失($T_C=25^\circ\text{C}$)	P_C	250	W
接合部温度	T_j	-65~175	°C
保存温度	T_{stg}	-65~175	°C

優れ、IMD-30dBでの出力は、入力7WPEPにて出力150WPEPとパワー・ゲインが高く、SSBでの電力増幅に有利です。

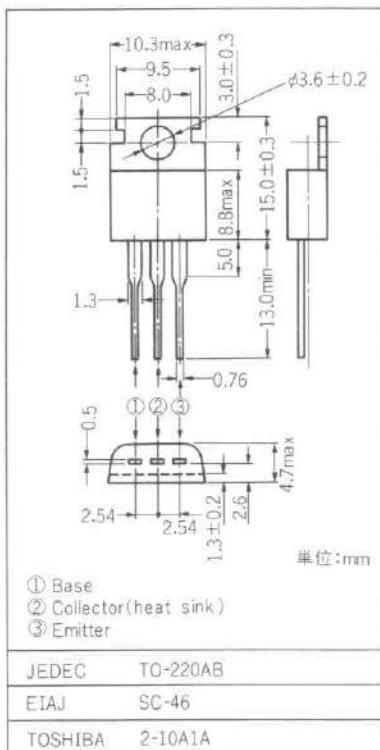
2 S C2098

ドライバー段電力増幅用として、4個をパラブッシュで使用しています。

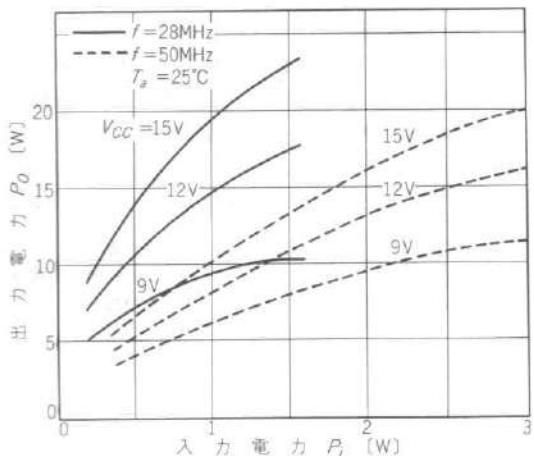
CHARACTERISTICS	SYMBOL	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=100\text{mA}, I_E=0$	35	—	—	V
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CES}$	$I_C=100\text{mA}, V_{EB}=0$	60	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	4	—	—	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{A}$	(10)	40~80	(150)	—
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=28\text{V}, I_E=0$ $f=1\text{kHz}$	—	450	600	pF
入力電力	P_i	$V_{CC}=28\text{V}, f=28\text{MHz}$ 2-tone $\Delta f=1\text{kHz}$, $\eta_C \geq 35\%$, $I_{idle}=100\text{mA}$, $P_o=150\text{W}_{\text{PEP}}$	—	7	8.5	W_{PEP}

第3表
TH P150/2 S C2510
の電気的特性

第7図
2SC2098の
外形寸法



第8図 2SC2098の入出力特性



外形図を第7図に、各特性を第8図～第12図および第4表、第5表に示します。

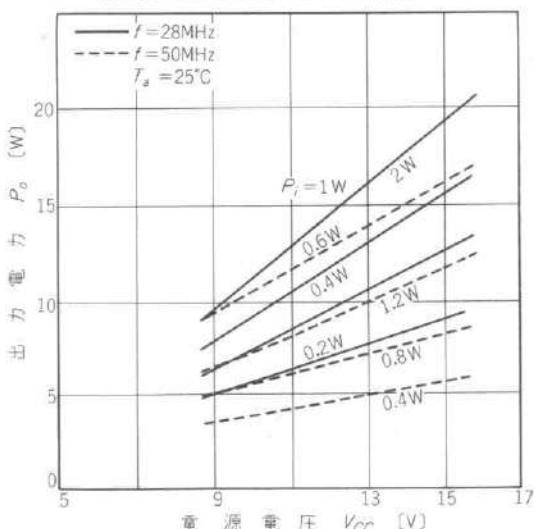
■ 2SC1164

受信ブリリアンプに使用している、VHF・UHF共聴ブースター出力段用トランジスタです。バイポーラ・トランジスタながら混変調・相互変調特性に優れています。外形図を第13図に、各特性を第6表、第7表および第14図～第19図に示します。

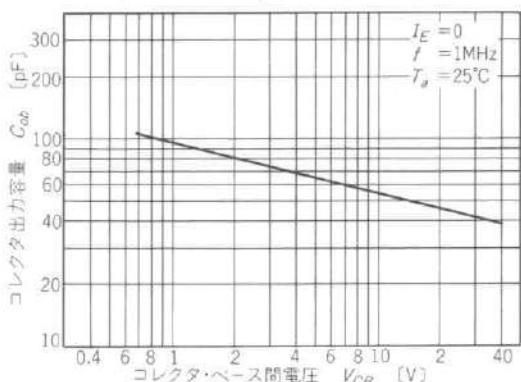
回路構成

■ 終段電力増幅回路

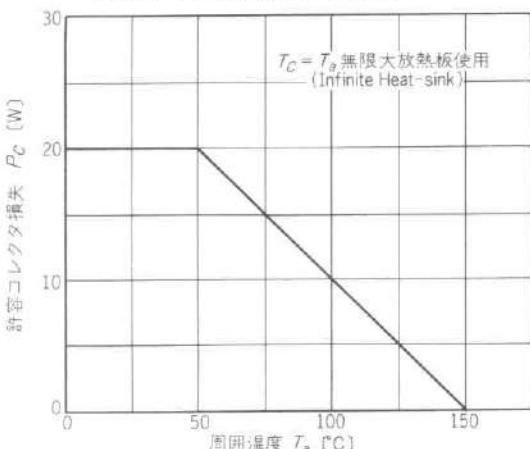
第9図 2SC2098のPo-VCC特性



第10図 2SC2098のCob-VCB特性

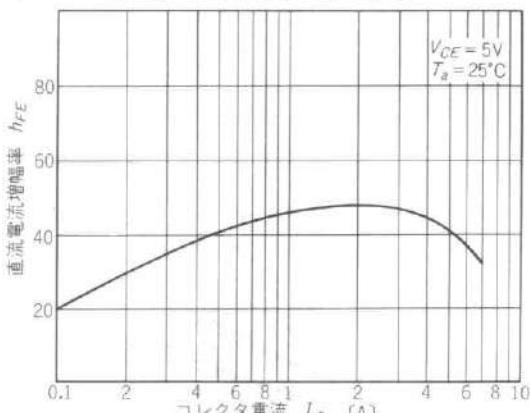


第11図 2SC2098のPc-Ta特性



パワーアンプ・ブロックの回路を第20図に示します。パワー・ゲインは約13dBあり、ドライブ電力10Wにて出力は約200Wを得ています。

このアンプ2台を第2図の分配・合成回路にて並列運

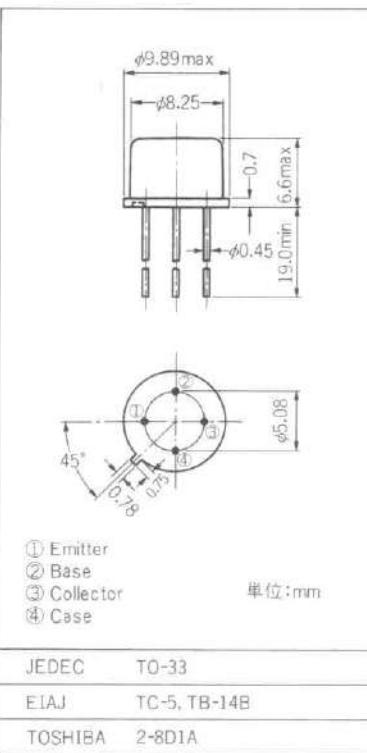
第12図 2SC2098の h_{FE} - I_C 特性

第4表 2SC2098の最大定格

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	70	V
コレクタ・エミッタ間電圧 ($R_{EB}=10\Omega$)	V_{CER}	70	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	4	V
コレクタ電流	I_C	6	A
エミッタ電流	I_E	-6	A
コレクタ損失 ($T_C=50^\circ C$)	P_C	20	W
接合温度	T_J	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~150	°C

転を行い、ドライブ電力20Wにて出力400Wを取り出します。

一般的に、ブッシュブル增幅では偶数次高調波は出力側で打ち消されて低減しますが、奇数次高調波は打ち消

第13図
2SC1164の外形寸法

されないため、偶数次高調波よりレベルが高くなります。その傾向を第21図に示します。

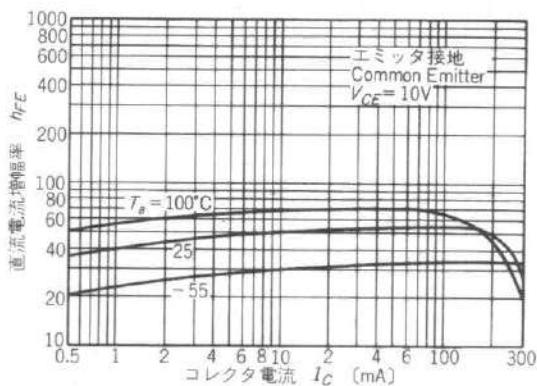
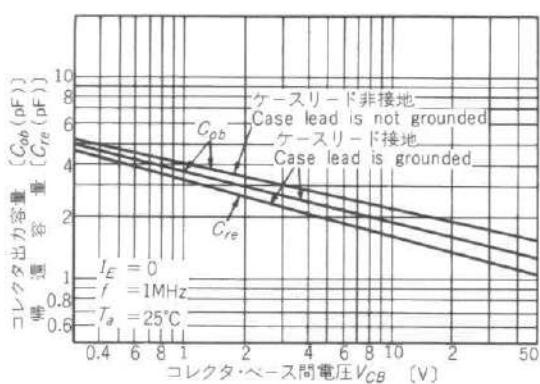
本機のパワー・アンプ回路の特長は、2重NFBループと入力側イコライザ回路をもつ点で、出力周波数特性および奇数次高調波レベルの改善に役立っています。

第20図の回路図において、 $R_{20-27}-C_{52-59}-L_3/R_{45}$, L_4 , R_{49} のNFBループで中域補正を行い、 $C_{57}-R_{36}$

第5表
2SC2098の電気的特性

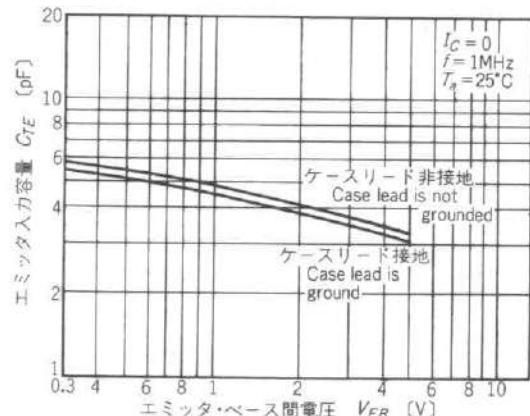
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=40V$ $I_E=0$	—	—	0.1	mA
コレクタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=1mA$ $I_E=0$	70	—	—	V
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CER}$	$I_C=10mA$ $R_{EB}=10\Omega$	70	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=1mA$ $I_C=0$	4	—	—	V
直流電流増幅率*	h_{FE}	$V_{CE}=5V$ $I_C=4A$	20	—	100	—
コレクタ・エミッタ間飽和電圧*	$V_{CE(sat)}$	$I_C=4A$ $I_B=0.4A$	—	—	1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=5V$ $I_C=0.5A$	100	—	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1MHz$	—	80	120	pF
出力電力(1)	$P_{o(1)}$	$V_{CC}=12V$ $f=28MHz$ $P_i=1W$ $\eta_C \geq 60\%$	13	15	—	W
出力電力(2)	$P_{o(2)}$	$V_{CC}=12V$ $f=50MHz$ $P_i=3W$ $\eta_C \geq 60\%$	—	16	—	W

*: Pulse Test : Pulse Width $\leq 100\mu s$, Duty Cycle $\leq 3\%$

第14図 2SC1164の h_{FE} - I_C 特性第16図 2SC1164の C_{ob} , C_{re} - V_{CB} 特性第7表
2SC1164の電気的特性

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CE} = 20V, I_E = 0$	—	—	0.3	μA
コレクタ遮断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 20V, I_E = 0$	—	—	1.0	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 2V, I_C = 0$	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 5mA, I_B = 0$	35	—	—	V
直流電流増幅率 (Note)	h_{FE}	$V_{CE} = 10V, I_C = 50mA$	25	—	90	—
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 50mA, I_B = 5mA$	—	—	0.7	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 50mA, I_B = 5mA$	—	—	1.1	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 20V, I_E = -50mA$	1100	1400	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 15V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	2.2	3.0	pF
ベース拡がり抵抗	$r_{bb'}$	$V_{CE} = 6V, I_E = -2mA$	—	—	15	Ω
雑音指数	NF	$V_{CE} = 20V, I_C = 10mA$ $R_g = 50\Omega, f = 200MHz$	—	4.0	5.0	dB
電力利得	G_{Pe}	$V_{CC} = 20V, I_E = -50mA$ $f = 200MHz$	10	14	—	dB

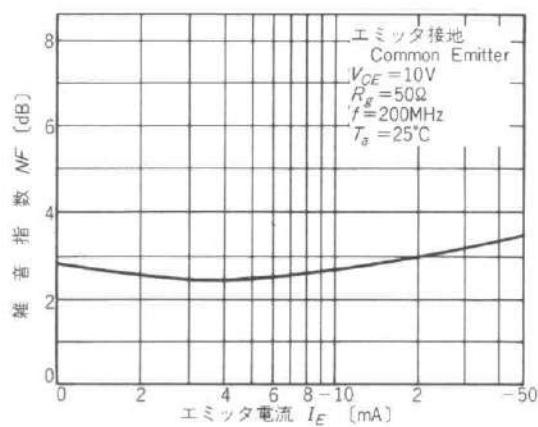
Note h_{FE} により下記のように分類し、現品表示しております。
R:25~50, O:45~90

第15図 2SC1164の C_{TE} - V_{EB} 特性

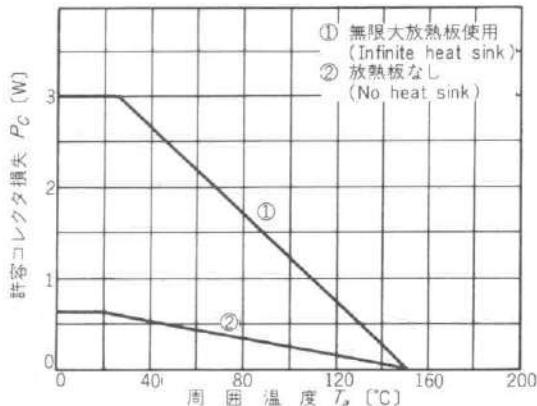
第6表 2SC1164の最大定格

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	35	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	3	V
コレクタ電流	I_C	300	mA
エミッタ電流	I_E	-300	mA
コレクタ損失	P_C	600	mW
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~150	°C

第17図 2SC1164のNF-IE特性



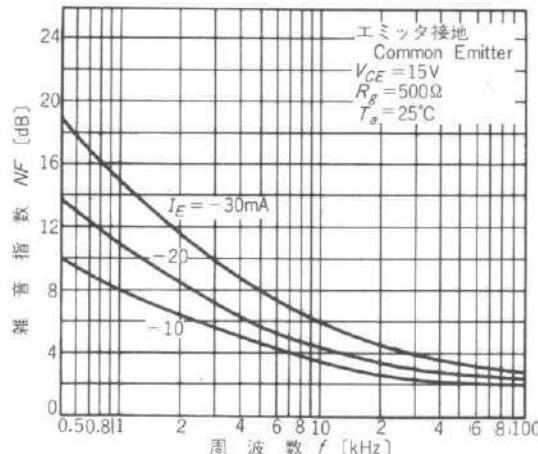
第19図 2SC1164の $P_C - Ta$ 特性



$\cdot 37/R_{38 \sim 39}$ の NFB ループにて低域補正と奇数次高調波の低減を、 $R_{8 \sim 9 \sim 10 \sim 14 \sim 15 \sim 16}/C_{41}$ のイコライザ回路にて高域補正を行っています。

NFBなしとNFB／イコライザー付きの周波数特性の違いの傾向を第22図に示します。

第18図 2SC1164のNF-f特性



■ ドライバー・アンプ

広帯域型ドライバー・アンプ・ブロックの回路図を第23図に示します。

- 2SC2098を4個バラブッシュ増幅にて、終段パワー・アンプを余裕をもってドライブしています。
- NFBは終段と同じく2重NFBをかけています。
- 電源ラインに直列に抵抗($R_{66 \cdot 67}$)を挿入し、必要以上のパワー・レベルに達した場合、自動的に電圧を下げるトランジスタの安全を配慮しています。

■受信プリアンプ

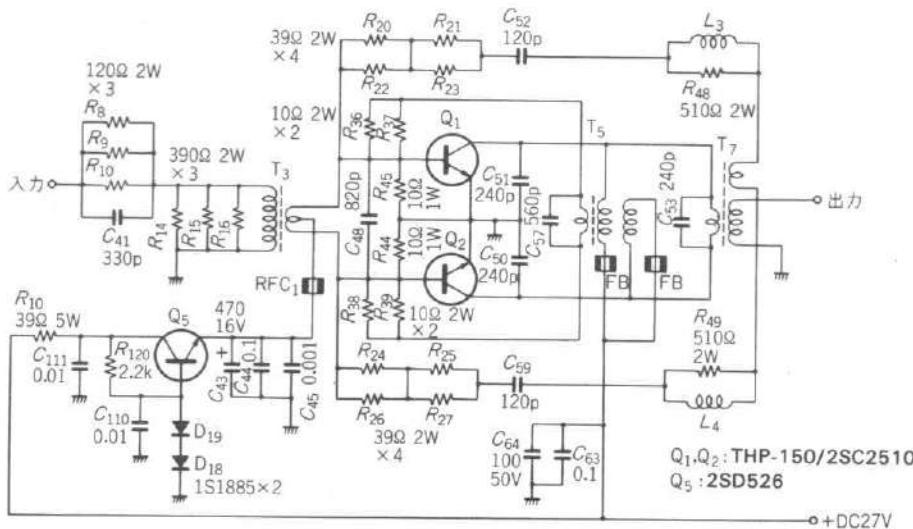
回路図を第24図に示します.

入・出力側とも非同調で、コレクタ側に1:1のパンを使用して広帯域設計を行っています。

D₁～D₄は保護用ダイオードです。

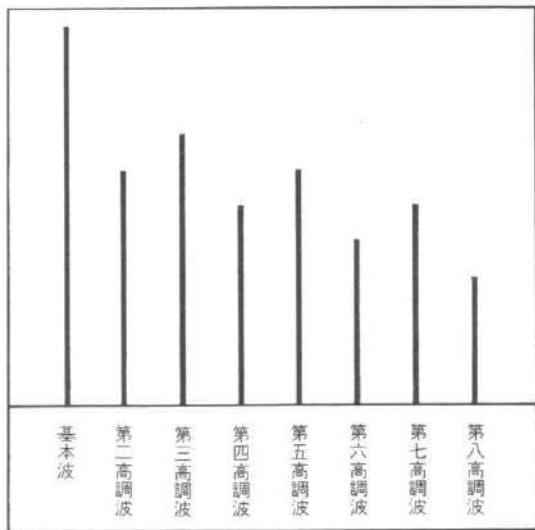
■キャリア・コントロールと保護回路

キャリア・コントロール回路と保護回路は一体化されており、その回路は第25図のとおりです。



第20図
終段電力增幅回路
ブロック

第21図 ブッシュブル増幅器のスプリアス発生の傾向



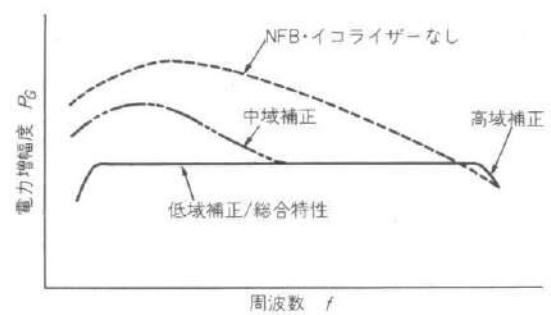
$Q_{17} \sim 18$ はキャリア・コントロールで、トランシーバーが送信状態になると、トランシーバーの高周波信号が C_{10} を通り D_{18} で整流されて Q_{17} を ON し、次いで Q_{18} を ON してリレー (R_{L-1}) を駆動、パワー・アンプをドライブします。

トランシーバーが受信状態に戻ると、 C_{10} を通る高周波信号が切れるため、 $Q_{17} \sim 18$ は OFF となり R_{L-1} は受信状態に戻ります。

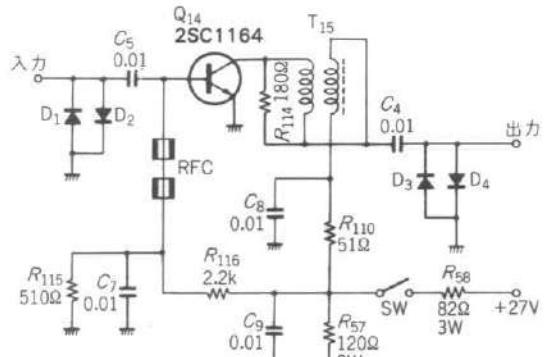
$Q_{20} \sim Q_{21} \sim D_{32}$ は保護回路です。

送信状態において、もし、アンテナ負荷の SWR が高い、ドライブ・レベルが高すぎるなど、終段パワー・トランジスタへのストレスが大きくなつた場合、それぞれの検出回路で検出された直流信号が、保護回路の $D_{15} \sim D_{32}$ を通り ⑧点を通過して、 Q_{21} のベースに加わります。

第22図 広帯域増幅器の周波数特性



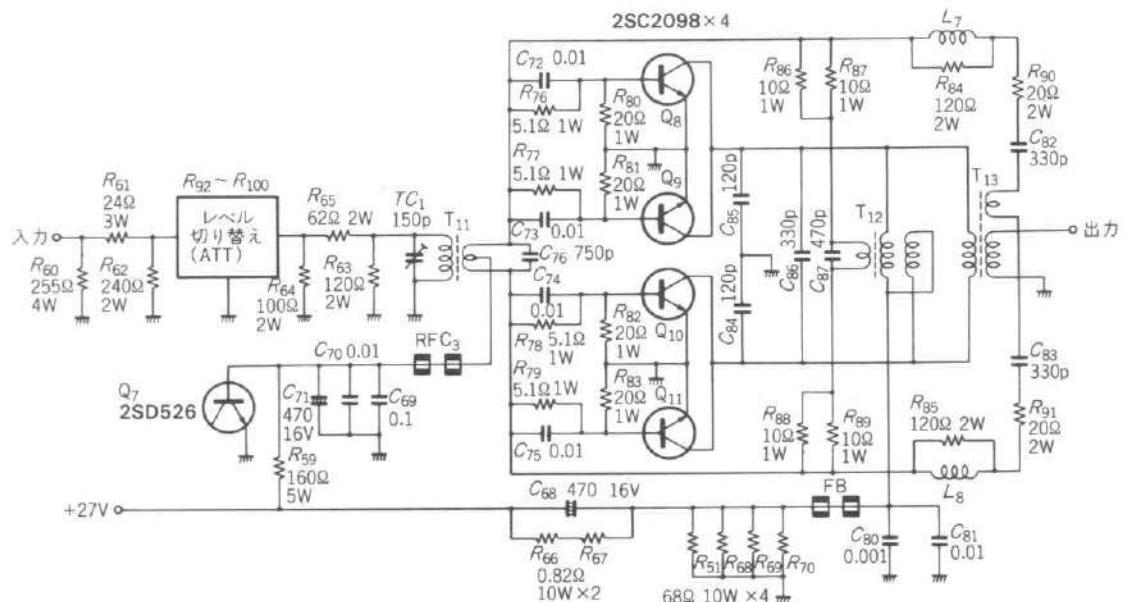
第24図 HF広帯域受信ブリアンプ回路



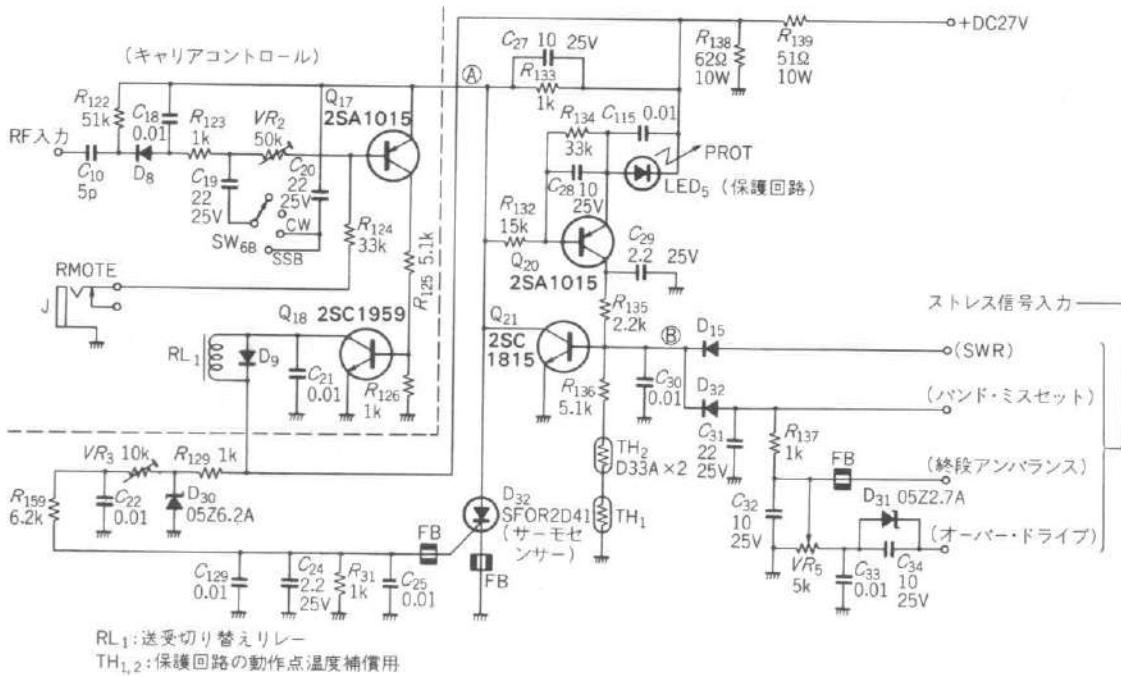
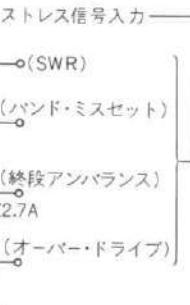
トランシーバーへのストレスが大きくなつた場合、それぞれの検出回路で検出された直流信号が、保護回路の $D_{15} \sim D_{32}$ を通り ⑧点を通過して、 Q_{21} のベースに加わります。

Q_{21} が ON、次いで Q_{20} が ON となり、この回路で、いわば直流の発振回路とでもいうべきループを形成し、

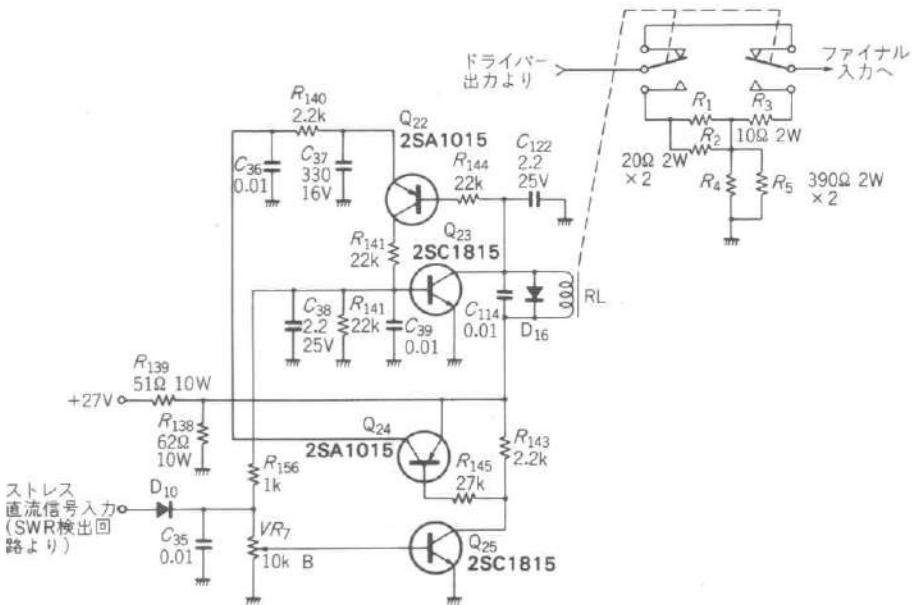
第23図 ドライバー・アンプの回路



第25図 キャリア・コントロールと保護回路

RL₁:送受切り替えリレーTH_{1,2}:保護回路の動作点温度補償用

第26図
自動復帰型SWR
セーフティ・コン
トロール



ON状態にロックされ、⑧点に加わるストレス信号が切
れても、その状態を保持します。

さて、保護回路のオンロックにより、Q₂₁のコレクタ
エミッタ間がショート状態となり、R₁₃₃で大きな電圧降
下を生じて、⑧点の電圧はほとんどゼロになってQ₁₇・
Q₁₈のキャリア・コントロール回路をOFFすることに
なります。

過熱保護は、サイリスタ (D₃₂ SFOR2D41) を使

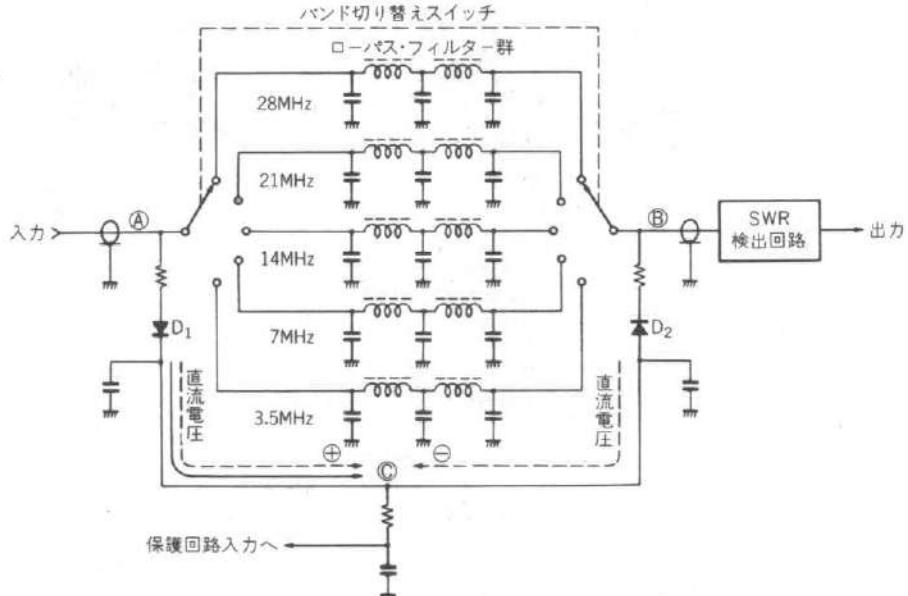
用して、過熱の検出と保護回路のロック機能を兼用して
います。

サイリスタは、ゲート電圧を一定に保っても周囲温度
が変化すると点弧特性も変化する性質を利用しています。

保護回路が動作してロックされますと、ストレスが回
復してももとに戻りませんので、復帰させるには電源ス
イッチをいったん切り、再び入れます。

■自動復帰型SWRセーフティ・コントロール

第27図
バンドセレクト・
ミスセット・センサー



アンテナ負荷のSWRが悪化すると、自動的に終段出力を下げてパワー・トランジスタへのストレスを軽減し、運用途中でSWRが回復すると、また自動的にフルパワーに復帰します。

コントロール回路を第26図に示します。

出力を下げる方法は、リレーの切り替えにより終段へのドライブ・ラインに抵抗アッテネーターを挿入し、ドライブ・レベルを小さくして出力を下げます。

第26図の回路において、 $Q_{22} \cdot Q_{23}$ はストレス信号の入力により、リレーを駆動しロックする回路で、 $Q_{24} \cdot Q_{25}$ にて、リレー駆動回路の電源をコントロールします。

■ バンドセレクト・ミスセット・センサー

回路を第27図に示します。

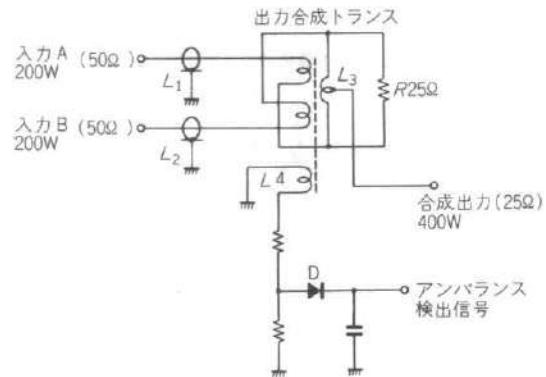
バンド切り替えスイッチが使用周波数に対し正しくセットされていれば、ローパス・フィルター回路での通過ロスが若干あったとしても、Ⓐ点とⒷ点の高周波電力はほぼ同じと考え、 D_1 および D_2 で検波された直流電圧はそれぞれ等しい値で極性が逆のため、Ⓒ点では互いに打ち消されて電圧がほとんど現れません。

しかし、バンド切り替えスイッチが使用周波数に対し、間違って低い位置にセットされた場合、フィルター回路ではショートに近い状態となり、Ⓑ点での高周波電力はⒶ点のそれと比較すると著しくレベルが低くなります。その結果 D_1 および D_2 で検波された電圧に大きくアンバランスを生じ、Ⓒ点ではかなり大きなプラスの電圧が現れ、保護回路を動作させるのに必要な、十分大きなストレス信号となります。

■ ファイナル・アンプ、アンバランス・センサー

これは、2台の終段電力増幅器のうち、どちらか一方

第28図 ファイナル・アンプ、アンバランス・センサー



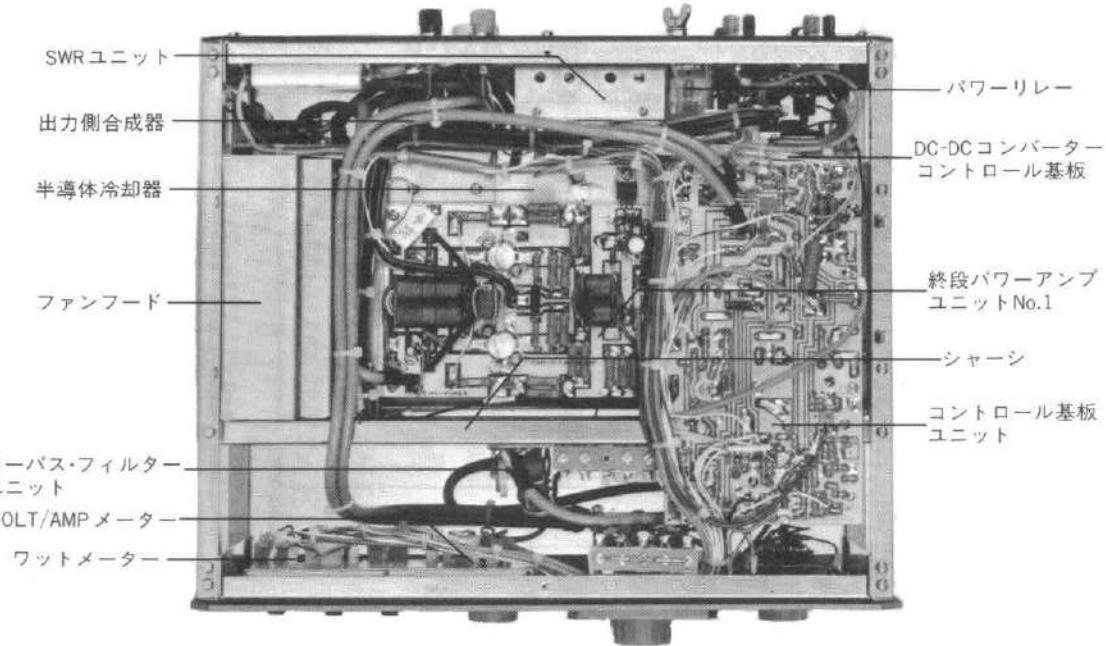
が万一故障した場合、出力合成回路の作用がアンバランスになることによる、片方の正常な増幅器の2次故障および合成回路の焼損を防止するための保護センサーです。回路図を第28図に示します。

回路図において、出力合成トランスの L_1 と L_2 に同じ周波数の同じ大きさの高周波電力が加わると、トランスで電力が合成され、 L_3 の中点より倍の電力が取り出されます。

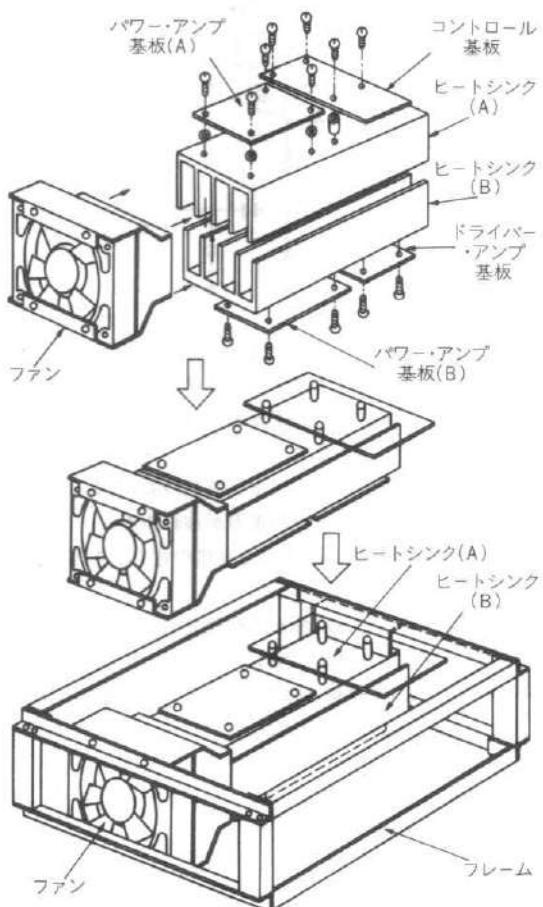
このとき、 L_1 と L_2 に加わる高周波電力が、同位相・同周波数・同レベルになればバランスがとれ、 R の両端および L_4 には電力は現れません。

もし、 L_1 と L_2 のうちどちらか一方のコイルにのみ電力がかかり、もう片方のコイルに電力がかからない場合、トランスの作用はアンバランスとなり、 R (25Ω) の両端および L_4 には、著しく大きな高周波電圧が発生します。

アンバランス動作により、 L_4 で発生した高周波電圧



第29図 主要部分の基本構造



はダイオードDで整流して、直流信号を保護回路へ送ります。

なお、正常な動作状態において、入力Aと入力Bにごくわずかな電力差があった場合、差の分だけの電力が L_A の両端に現れて、 R (25Ω) で吸収し、バランスを保ちます。

構造と配置

■ 内部構造

2枚のパワー・アンプ基板、ドライバー・アンプ基板、コントロール基板(キャリア・コントロール回路、受信ブリアンプ回路、セーフティ・コントロール回路、保護回路を收容)、ファイナル・アンプ出力合成基板、13.8V AVR基板の6枚を、同じ梯状ヒートシンク2個に分散して取り付け、さらに第29図のようにヒートシンクの梯部(フィン)を互いに組み合わせて、モーター・ファンでフィンのすき間に風を送って冷却します。

ヒートシンクにファンと基板を取り付けると、上下の方向性のない立体構造となるため、必然的にフレームを設け、このブロック全体を宙吊りにしてフレームの左右で固定する型になります。

内部の部品の取り付けについて、上面より見た様子を写真5に、底面より見た様子を写真6に示します。

■ 前面パネルの配置(写真7)

〈各部の説明〉

- ① POWER: 電源スイッチです。
- ② POWER (13.8V): 出力端子を背面に設けた、

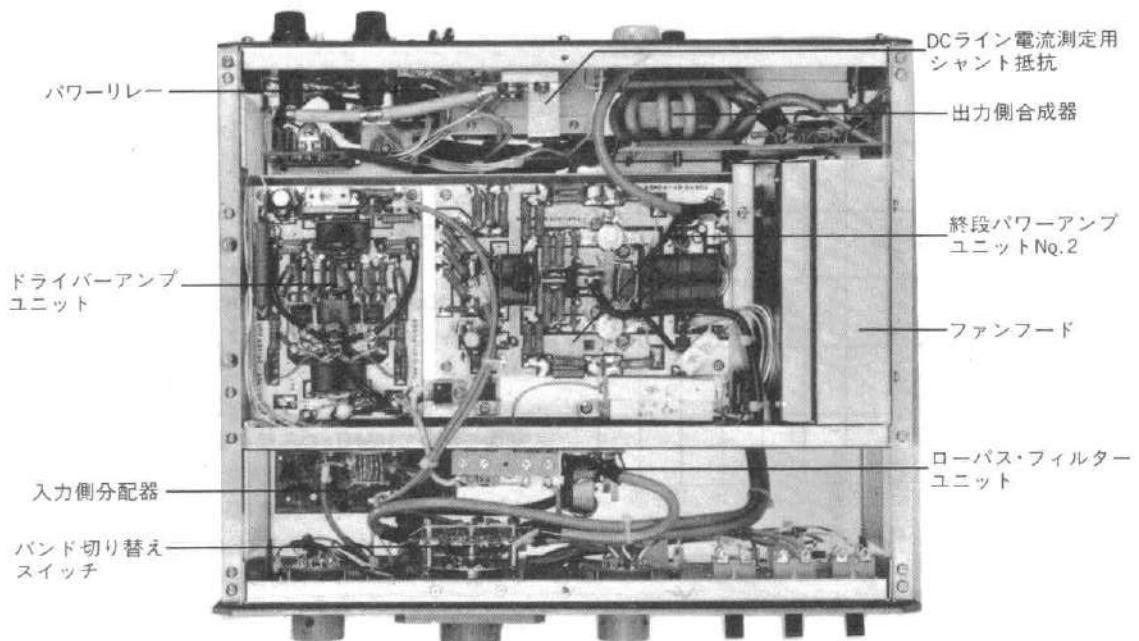


写真6 本体底面

トランシーバー用電源(DC-DCコンバーター)

専用スイッチです。

③ RX: 受信プリアンプ用電源スイッチです。

④ METER: 電圧計／電流計⑩の切り替えスイッチです。

⑤ BAND: バンド切り替えスイッチです。オプションにて組み込んだ場合の、リニア・アンプ出力側のローパス・フィルターを切り替えます。

⑥ MODE: 使用モードにより、キャリア・コントロールのタイムラグを切り替えるスイッチです。CWで約1秒、SSBで約2秒、AM/FAN HIでは瞬時です。

⑦ キャリア・コントロールのタイムラグが、CWまたはSSB用になっていることを示すランプです。

⑧ キャリア・コントロールのタイムラグが、AM用

になっていることを示すランプです。

⑨ PROT: 保護回路が動作したことを示すランプです。

⑩ POWER LEVEL: 出力切り替えスイッチです。

⑪ 電圧計／電流計: 切り替えスイッチ④の操作により、電源電圧・消費電流・13.8V出力の電圧を指示します。

⑫ 出力電力計: リニア・アンプの送信出力を指示します。

⑬ RX: 受信プリアンプが動作していることを示すランプです。

⑭ OUT (13.8V): DC-DCコンバーターの動作表示ランプです。

⑮ ON AIR: リニア・アンプが動作しているこ

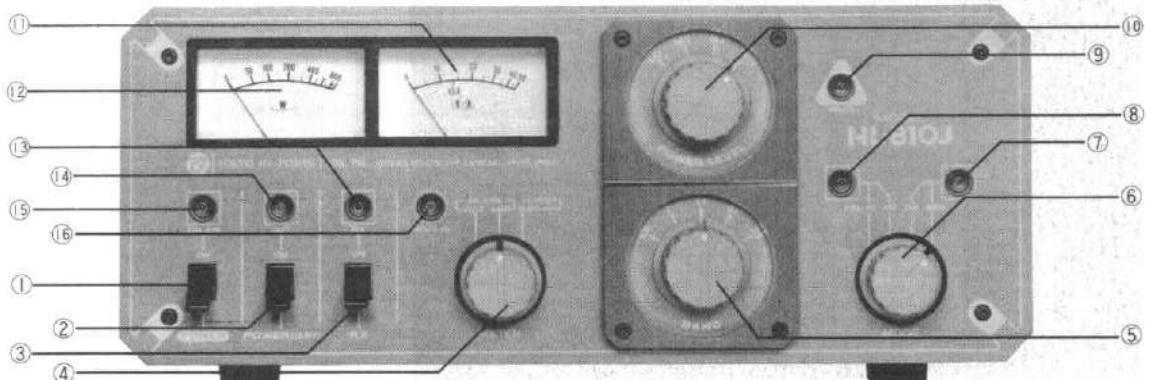
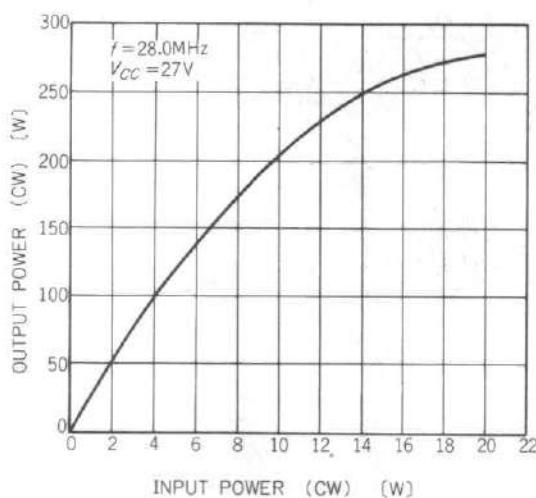


写真7 前面パネル

第30図 終段パワー・アンプ入・出力特性(単体)



とを示すランプです。

- ⑯ INPUT HI : 入力レベルが20W仕様に切り替わったことを知らせるランプです。

第31図 終段パワー・アンプ出力周波数特性(単体)

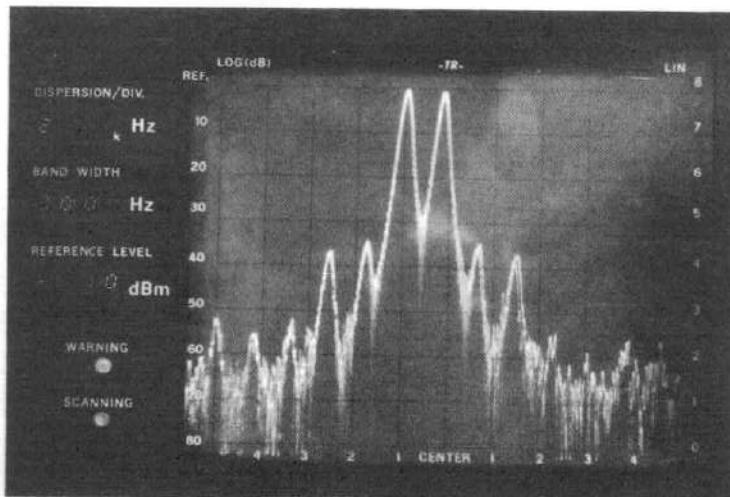
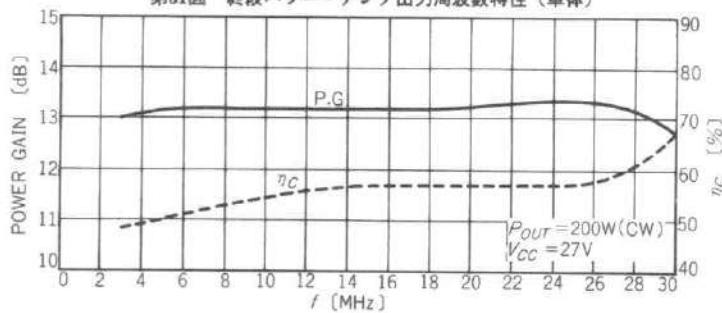


写真8 スペアナ・スクリーン (IMD 14MHz500W PEP -34dB)

特 性

■入・出力特性

無変調キャリアの入力レベルを変えることによる、出力の変化の様子を第30図に示します。28MHz帯のみ載せました。

■第3次混変調歪 (IMD)

S Bモードにて、2信号(トランシーバーのマイク端子に700Hzと2300Hzを混合した、低周波信号を加えて変調をかける)テストによる3次歪(IMD)を、スペクトル・アナライザで観測した模様を写真8に示します。

誌面の都合で14MHzのみ載せました。

■終段パワー・アンプ出力周波数特性

合成前の単体での特性を第31図に示します。出力200Wでのパワー・ゲインの周波数特性です。

2台合成した場合の出力周波数特性は分配/合成回路の影響が出るので、単体での特性よりも多少悪くなっています。

おわりに

本機は昭和55年の夏頃に設計されたもので、すでに4年を経過しているため、設計も古くなってしまっており改良すべき点もいくつかあります。

また、今日パワーMOS FETも含め新種のパワー・デバイスも出現していますが、この解説記事が読者諸兄の参考になれば幸いと存じます。

■参考文献

- MOTOROLA Application Note
①AN-749: BROADBAND TRANSFORMERS AND POWER COMBINING TECHNIQUES FOR RF

担当 H. Granberg

- ②AN-758: A TWO-STAGE 1KW SOLID-STATE LINEAR AMPLIFIER

担当 H. Granberg

- TOSHIBA SEMICONDUCTOR DATA BOOK '80.1

東京芝浦電気株式会社 半導体事業部